

ニュースガイド No. 10579

<日本特許・実用新案明細書収録セット>
 *最新の特許情報が満載!

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

無電解貴金属メッキ方法と工程

[公開編]平成22年(1年間) 59点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥18,900-	¥18,000-
全文紙収録 B5製本版	¥18,900-	¥18,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥28,350-	¥27,000-

既刊関連セットのご案内

No.	公開特許		平.	点	(本体価格)
No,10493B	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.21	60点	¥18,000
No,10493A	"	"	平.20	60点	¥18,000
No,10201B	"	"	平.19	66点	¥23,100
No,10201A	"	"	平.18	66点	¥23,100
No,9997C	"	"	平.17	84点	¥18,600
No,9997B	"	"	平.16	65点	¥19,200
No,9997A	"	"	平.15	62点	¥18,300
No,9520	"	"	平.13-14	84点	¥16,800
No,8537	"	無電解ニッケルメッキ方法と浴の組成	平.7-9	65点	¥28,000
No,10199	"	無電解スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.15-19	62点	¥24,885
No,9998	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.13-17	100点	¥29,600
No,9189	"	"	平.10-12	68点	¥24,800
No,9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-12	71点	¥27,700
No,9086	"	銅めっき装置の構造と付属装置	平.5-12	70点	¥27,400
No,9087	"	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-12	71点	¥27,700
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-11	81点	¥31,600
No,8926	"	半田メッキ方法と工程	平.5-11	75点	¥29,700
No,8868	"	半導体ウェーハのメッキ方法と工程	平.5-11	103点	¥35,000
No,9190	"	銀合金メッキ方法と浴の組成	平.5-12	68点	¥24,700

*お申し込み方法...下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com)

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容	
	ニュースガイドNo.	
	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
所属部署名	題名	
	合計 ¥	
担当者名	E-mail:	
	TEL:	FAX:
住所:〒		

料金には別途送料がかかります。

無電解貴金属メッキ方法と工程

No. 10579

[公開編] 平成22年(1年間) 59点

CD-ROM版 ¥18,900

B5製本版 ¥18,900 (全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥28,350)

- | | | | | | |
|----|---|-----------------|----|---|---|
| 1 | めっき用めっき未析出材料、ならびにプリント配線板 | 株式会社カネカ | 30 | 金属線を有する基板及びその製造方法 | 旭化成イーテリアルズ株式会社 |
| 2 | パターンめっき皮膜、及びその形成方法 | エヌ・イーケムキャット株式会社 | 31 | 半導体装置の製造方法 | 富士電機システムズ株式会社 |
| 3 | 連続した長尺の金属ナノチューブ製造方法およびこの方法で製造した長尺の金属ナノチューブ | 国立大学法人山口大学 | 32 | 金属凸部を有するポリマー材料の製造方法 | 大阪府 |
| 4 | 接続端子部およびその製造方法 | 住友金属鉱山株式会社 | 33 | 無電解パラジウムめっき浴及び無電解パラジウムめっき方法 | 上村工業株式会社 |
| 5 | 高分子アクチュエータ素子およびその駆動方法 | イーメックス株式会社 | 34 | 電気接点の製造方法 | アルプス電気株式会社 |
| 6 | 複合材料及びその製造方法、並びにその製造装置 | 独立行政法人科学技術振興機構 | 35 | 半導体装置およびその製造方法 | 三菱電機株式会社 |
| 7 | 無電解メッキの前処理方法および該基材の無電解メッキ方法 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 36 | 金微細構造体形成用無電解金めっき液およびこれを用いた金微細構造体形成方法ならびにこれを用いた... | 関東化学株式会社 |
| 8 | 吸着剤 | 戸田工業株式会社 | 37 | 半導体装置およびその製造方法 | 株式会社東芝 |
| 9 | 電解用電極 | 旭化成ケミカルズ株式会社 | 38 | 無電解めっき前処理剤及びこれを用いた無電解めっき前処理方法 | 日鉱金属株式会社 |
| 10 | 無電解めっき用活性化液 | 奥野製薬工業株式会社 | 39 | 導電粒子、その製造方法及び異方性導電接着剤 | ソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社 |
| 11 | ニッケル-金メッキ方法及び印刷回路基板 | 三星電機株式会社 | 40 | 導電粒子、その製造方法及び異方性導電接着剤 | ソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社 |
| 12 | 機械部品およびその製造方法ならびにこれを用いた回転装置 | キヤノン電子株式会社 | 41 | 導電性粒子、及びその製造方法 | 国立大学法人京都大学 |
| 13 | 導電性繊維の製造方法 | 東レ・デュボン株式会社 | 42 | 置換析出型無電解金めっきの前処理用活性化液 | 奥野製薬工業株式会社 |
| 14 | ハーフミラーおよびその製造方法 | オムロン株式会社 | 43 | 金めっきされた繊維またはその構造体、およびその製造方法 | 東レ・デュボン株式会社 |
| 15 | めっき物及び無電解めっき方法 | 日本碍子株式会社 | 44 | 半導体装置およびその製造方法 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 |
| 16 | 無電解メッキ液 | 三星電機株式会社 | 45 | 半導体装置の製造方法 | 富士電機システムズ株式会社 |
| 17 | 配線パターンが形成されたプラスチック成形体の製造方法および配線パターンが形成された... | 日立マクセル株式会社 | 46 | 無電解金めっき浴 | 上村工業株式会社 |
| 18 | めっき析出物 | 日立化成工業株式会社 | 47 | 無電解パラジウムめっき液 | 小島化学薬品株式会社 |
| 19 | 還元型無電解金めっき用前処理液及び無電解金めっき方法 | 日立化成工業株式会社 | 48 | コンポジットナノチューブ、金属ナノチューブおよびそれらの製造方法 | 国立大学法人信州大学 |
| 20 | 導電性高強度繊維糸及びその製造方法 | 東レ・デュボン株式会社 | 49 | 銀被覆銅粉および導電ペースト | DOWAホールディングス株式会社 |
| 21 | 導電性繊維の製造方法 | 東レ・デュボン株式会社 | 50 | 電解プロセス用陰極 | インドゥストリエ・デ・ノラ・ソチエタ・ベル・アツィオーニキン・コック・ダニエル・チャン |
| 22 | 突起電極の形成方法及び置換金めっき液 | シャープ株式会社 | 51 | 弱アルカリ性の化学銀めっき溶液 | スミス アンド ネフューピーエルシー |
| 23 | 弾性変形部を備える接触子の製造方法 | アルプス電気株式会社 | 52 | 被覆 | ネーデルランド オルガニサチエ ヴォールトエゲパスト・ナツールウェテン... |
| 24 | 誘電体基材表面の触媒フリー金属化方法及び金属膜付き誘電体基材 | 国立大学法人大阪大学 | 53 | 成形製品の作製方法 | ネーデルランドセ オルガニサチエ フォールトエゲパストナトルヴェテ... |
| 25 | 成形回路部品の製造方法 | アキレス株式会社 | 54 | 非触媒作用的基体に金属を沈着させるための無電解法 | ヴェロシス インコーポレイテッド |
| 26 | 電子部品のめっき方法、及び電子部品 | 株式会社村田製作所 | 55 | 多孔質無電解めっき | ザ コート オブ エジンバラネピア ユニバーシティ |
| 27 | 銀メッキ銅微粉及び銀メッキ銅微粉を用いて製造した導電ペースト並びに銀メッキ銅微粉の製造方法 | 日鉱金属株式会社 | 56 | 燃料電池用の電極の製造方法 | コニカミルタホールディングス株式会社 |
| 28 | 弾性接点及びその製造方法、ならびに、接点基板及びその製造方法 | アルプス電気株式会社 | 57 | 有機薄膜トランジスタ及び有機薄膜トランジスタの製造方法 | |
| 29 | 非シアン無電解金めっき液及び導電パターンのめっき方法 | エヌ・イーケムキャット株式会社 | | | |

以下2点省略